

KOSDAQ | 자본재

아스플로 (159010)

시공 부품에서 장비 부품으로, 2026년이 진입 원년

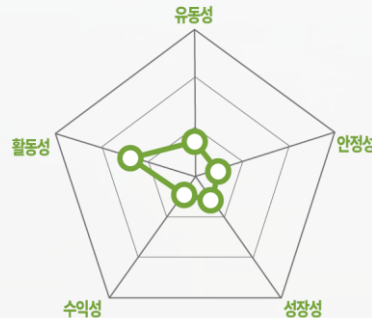
체크포인트

- 아스플로는 반도체 공정용 가스&화학 이송 배관 부품(고청정 튜브/파이프, 피팅, 밸브/레귤레이터, 디퓨저/필터)을 생산하는 기업. 2005년 일본 전량 수입에 의존했던 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화하며 삼성전자·SK하이닉스 공급사로 성장. 매출이 팽 신축 구간에 집중 투입되는 시공 용 부품 중심인 탓에 2025년 매출액 679억원(YoY -18.8%), 영업손실 70억원으로 7개 분기 연속 적자. 2026년 상반기 매출액 600억원(YoY +46.7%), 영업이익 58억원으로 턴어라운드
- 2022년 램리서치 벤더 등록 이후 다운사이클로 지연됐던 장비 부품 진입이 2026년 본격화. 램리서치형 약 1,000여 개 Weldment 품목 승인 진행으로 3Q26 일부 양산, 4Q26 양산 확대 예정
- 2026~2028년은 평택 P4-P5, 청주 M15X-P&T7, 용인 1기 팹 등 신규 팹 착공이 겹치는 구간. 여기에 2026년 초 북미 칩메이커 2개사(사·M사) 벤더 등록으로 20년간 국내 2개사에 집중됐던 매출처가 다변화되며, 다운사이클에서 30% 하락했던 시공용 판가가 2Q26 정상화

주가 및 주요이벤트

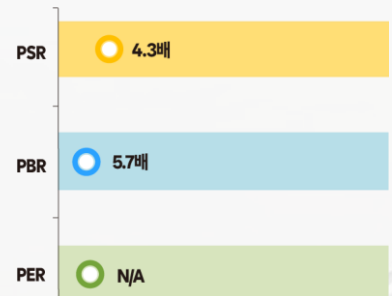


재무지표



주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류 상 산업재산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 1Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 산업재산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가

연구원 권지승 rnjswtmd32@kirs.or.kr

연구위원 이나연 lny1008@kirs.or.kr

자본재

시공 부품에서 장비 부품으로, 20년 준비의 결실

아스플로는 반도체 공정용 가스 및 화학 물질을 이송하는 배관 부품을 생산하는 기업으로, 2005년 고정형 튜브 국산화 이후 삼성전자·SK하이닉스 등 시공용 부품을 주력으로 성장. 아스플로는 장비 수명 주기와 공정 변화에 따라 교체 수요가 상시 발생하는 시공용 부품 시장에 진입하기 위해, 2018년 어플라이드 머티리얼즈 OEM 등록, 2022년 램리서치 벤더 등록을 통해 준비를 이어왔으나 2023~2025년 다운사이클에서 기존 벤더가 재고 소진으로 대응하며 후발 벤더에 배분될 물량 자체가 부재하며 지연. 2026년 1분기부터 '모듈'이 신규 매출 계정으로 공시되며 상반기 24억원이 인식된 점에서 장비 시장 진입이 실적으로 확인되기 시작한 국면으로 판단

램리서치 중심의 장비향 물량 확대

아스플로의 램리서치향 매출액은 2025년 약 30억원 수준이었으나 2026년 연초에만 2배 이상의 물량이 확정됐으며, 약 1,000여 개 Weldment(용접 배관 조립품) 품목 승인을 진행해 3Q26 일부 양산 후 4Q26 본격 확대 계획. 2026년 9월부터는 가스 블록 가공을 위한 머시닝 인증에도 착수. 장비용 배관 부품은 벤더 등록에 5년 안팎, 이후 품목별 승인에 1~2년이 추가로 소요되어 수요 급증 국면에서도 공급이 즉각 늘어날 수 없는 영역이며, 이미 승인 절차를 밟고 있는 소수 업체로 물량이 집중될 전망

2026년 매출액 1,301억원으로 사상 최대, 이익은 흑자 전환

2026년 연간 매출액 1,301억원(YoY +91.6%), 영업이익 153억원(YoY 흑자전환, OPM 11.7%)을 전망. 부문별 매출액은 튜브/파이프 723억원(YoY +90.1%), 밸브/레귤레이터 271억원(YoY +121.0%), 피팅 175억원(YoY +33.3%), 모듈 72억원(신규), 디퓨저/필터 59억원(YoY +31.6%)을 예상

Forecast earnings & Valuation

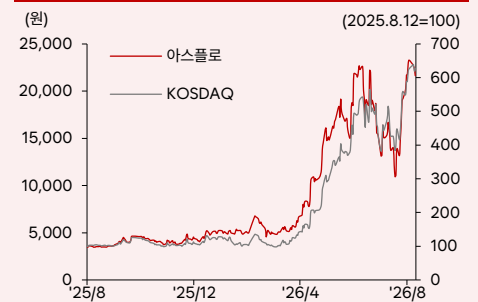
	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액(억원)	887	869	836	679	1,301
YoY(%)	505	-2.0	-3.8	-18.8	91.6
영업이익(억원)	105	64	-19	-70	153
OP 마진(%)	11.8	7.3	-2.2	-10.3	11.7
지배주주순이익(억원)	91	36	-24	-99	179
EPS(원)	679	268	-178	-745	1,345
YoY(%)	102.9	-60.5	적전	적지	흑전
PER(배)	14.1	38.8	N/A	N/A	16.1
PSR(배)	1.4	1.6	0.7	0.9	2.2
EV/EBITDA(배)	11.8	18.5	63.4	N/A	19.0
PBR(배)	2.4	2.4	1.0	1.4	4.5
ROE(%)	18.0	6.4	-4.2	-19.7	32.4
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (8/21)	21,650원
52주 최고가	23,300원
52주 최저가	3,485원
KOSDAQ (8/21)	801.94p
자본금	67억원
시가총액	2,887억원
액면가	500원
발행주식수	13백만주
일평균 거래량 (60일)	18만주
일평균 거래액 (60일)	33억원
외국인지분율	50.9%
주요주주	강도홍 외 3인 55.79%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	45.4	227.2	466.3
상대주가	33.7	368.6	444.8

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '순운전자본회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.



기업 개요

1 기업 개요 및 연혁

아스플로

고청정 튜브

국내 최초 국산화 성공

아스플로는 반도체 공정에서 사용되는 가스와 화학 물질을 이송하는 배관 부품(고청정 파이프/튜브, 피팅, 밸브/레귤레이터, 디퓨저/필터 등)을 제조, 판매하는 기업이다. 아스플로의 강두홍 대표는 1994년 국민대학교 금속재료공학과를 졸업한 후 진일특수 개발팀과 EP(Electro Polishing; 전해연마) 연구소장을 거쳐 2001년 아스플로를 설립했다. 진일특수는 1990년대 당시 일본에서 반도체용 배관 기술을 들여오는 삼성전자의 1차 공급사였고, EP 연구소는 파이프나 튜브 등의 부품 내부의 표면을 처리하는 기술인 전해연마를 다루는 연구소였다. 이를 토대로 2005년 강두홍 대표는 일본으로부터 전량 수입에 의존하던 고청정 튜브를 국내 최초로 국산화에 성공했다.

2005년 삼성전자 납품을 시작으로, 2006년 SK하이닉스에 공급하기 시작했고, 2018년부터는 세계적인 반도체 장비사인 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials; AMAT)의 OEM 부품 공급사로 선정되었다. 2024년 11월에는 원가 경쟁력 확보와 중국 시장 진출을 위해 중국 쑤저우(Suzhou)에 생산법인을 설립해 현지 생산 거점을 확보했다. 또한, 2026년 1월 북미 소재 글로벌 칩메이커 2개사(사, M사)의 공급사(Supplier) 등록을 완료하는 등, 고객 기반을 국내 2개사 중심에서 글로벌 장비사 및 칩메이커 전반으로 확장하고 있다.

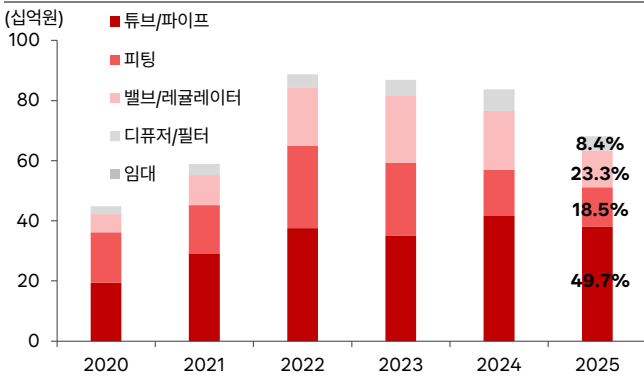
아스플로는 2025년 연간 매출액 679억원(YoY -18.8%), 영업손실 70억원(YoY 적자지속)을 기록했다. 주요 제품별 매출액은 튜브/파이프 380억원(YoY -8.5%), 피팅 131억원(YoY -15.3%), 밸브/레귤레이터 123억원(YoY -37.0%), 디퓨저/필터 45억원(YoY -36.4%)이며, 매출 비중은 각각 56.0%, 19.3%, 18.1%, 6.6%이다. 지역별 매출액은 국내 442억원, 중국 129억원, 일본 75억원, 기타 33억원으로, 매출 비중은 각각 65.1%, 19.0%, 11.1%, 4.8%이다.

아스플로 연혁

2001~2012	2013~2017	2018~
2001.11 ㈜아스플로 법인설립 2002.05 중국상해 현지사무소 개설 2002.07 부품소재 전문기업 지정 2002.12 기술혁신형(INNO-BIZ) 중소기업 선정 (중소기업업청) 2003.04 CLEAN 사업장 인증획득 2004.11 100만불 수출의 탑 수상 2004.11 기술연구소 설립 2004.11 특허권(반도체용 접속배관의 내면처리 방법) 획득 2005.03 본사 사업장 이전 (경기도 화성시 정남면 서봉로 797-13) 2005.06 특허권(구름 산화 부동태막 표면처리 방법) 획득 2005.06 특허권(구름 산화 부동태막 표면처리 장치) 획득 2005.06 기업부설연구소 인증(한국산업기술진흥협회) 2008.02 특허권(주름박이 표면처리 방법) 획득 2008.03 미국 3A 인증획득 2008.03 특허권(금속박의 표면처리 장치 및 방법) 획득 2008.1 경기도 유명중소기업 선정 2008.1 지식경제부 장관 표창장 수상 2008.11 한국정밀산업기술대회 기계/요소 부문 수상(기술표준원장) 2008.12 신제품인증 NEP 획득(지식경제부 인증) 2009.07 특허권(다공성 금속 멤브레인의 제조방법) 획득 2009.11 300만불 수출의 탑 수상 2010.11 NEP 협회 지식경제부 장관 표창 2010.11 특허권(세라믹이 코팅된 반도체 제조용 부품 제조방법) 획득 2011.01 SK Hynix 품질 인증 2012.05 특허권(회전 척 및 그를 이용한 단조품 가공장치) 획득	2013.05 특허권(알루미늄 기재에 내열성 세라믹 코팅막을 형성하는 방법) 획득 2013.05 특허권(다이아프램 밸브의 핸들 풀림 방지장치) 획득 2013.06 수출유망 중소기업 지정 (경기지방중소기업청) 2013.06 벤처기업확인서 인증 (한국벤처캐피탈협회) 2013.1 주요 제품(Valve & Regulator) 삼성전자 및 SK하이닉스 제품등록 2013.11 특허권(배관의 내경연마기 및 그를 이용하는 내경연마장치) 획득 2013.11 산업자원부 소재부품 기술개발사업 선정 2014.07 부품소재 전문기업 확인서 획득 (산업통상자원부) 2014.07 품질경영시스템 인증 (ISO 9001) 2014.07 환경경영시스템 인증 (ISO 14001) 2014.07 특허권(진공 포트용 소켓) 획득 2014.11 기술혁신형(INNO-BIZ) 중소기업 선정 (중소기업청) 2015.05 특허권(연마장치 및 이를 이용한 관 내부의 화학기계적 연마방법) 획득 2015.06 경영혁신형(MAIN-BIZ) 중소기업 선정 (중소기업청) 2015.09 제2공장 신축 (경기도 수원시 고색산업단지 내) 2015.09 벤처기업확인서 인증 (한국벤처캐피탈협회) 2016.04 KISTI 패밀리가업 지정 (한국과학기술정보연구원) 2016.04 특허권(가스레굴레이터 성능시험장치, 이를 이용한 히스테리시스, 유량변화 응답 및 설정값 안정성 시험방법) 획득 2017.01 미국기계학회(ASME) 인증 2017.04 강소기업 인증 (고용노동부) 2017.07 부품소재 전문기업 확인서 획득 (산업통상자원부) 2017.07 품질경영시스템 인증 (ISO 9001) 2017.07 환경경영시스템 인증 (ISO 14001) 2017.1 경기도 유명중소기업 인증 2017.12 기술혁신형(INNO-BIZ) 중소기업 선정 (중소벤처기업부)	2018.04 글로벌강소기업 인증 (중소벤처기업부) 2018.05 벤처기업확인서 인증 (기술보증기금) 2018.06 경영혁신형(MAIN-BIZ) 중소기업 선정 (중소벤처기업부) 2018.06 KISTI 패밀리가업 지정 (한국과학기술정보연구원) 2018.09 중소기업 R&D 우수사례기업 선정 (중소벤처기업부) 2018.10 중소기업융합대전 산업포장장 수상 (중소벤처기업부) 2018.10 제13회 디지털노베이션 대상 수상 (한국일보) 2018.11 기술상 수상 (사단법인 한국분말아카데미) 2019.10 국가연구개발 우수성과 100선 수상 2019.12 제90차 IR52 장영실상 수상 2020.07 한국산업기술평가관리원 소재부품장비전문기업 획득 2020.07 산업통상자원부 우수기업부설연구소(ATC+) 지정 2020.11 본사 및 제1공장, 연구소 이전 (경기도 화성시 정남산업단지 내) 2020.12 산업통상자원부 "100대 핵심전략품목 으뜸기업" 선정 2021.01 산업통상자원부 소부장 으뜸기업 22개업종 당사 선정 2021.03 A사 공급사 인증 통과, Special Process 인증 평가 2021.10 코스닥시장 상장 2023.08 ASME BPE 경신 인증 2024.10 중국 법인 설립 ASFLOW(Zhejiang)Semiconductor New Materials Co.,LTD. (CHINA) 2024.11 중국 법인 청산 ASFLOW(Zhejiang)Semiconductor New Materials Co.,LTD. (CHINA) 2024.11 중국 법인 설립 Asflow Semiconductor Technology(Suzhou) Co., Ltd.

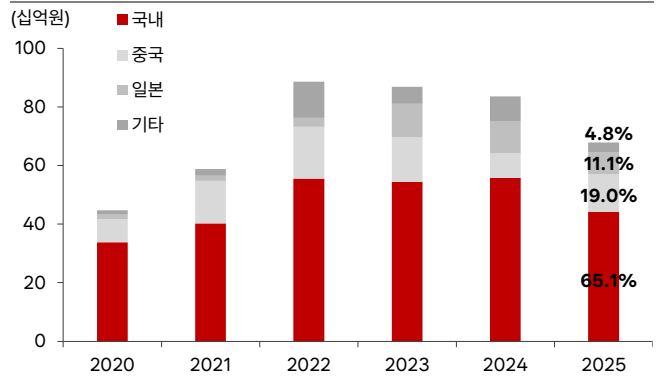
자료: 아스플로, 한국IR협회의 기업리서치센터

아스플로 제품별 매출액 추이



자료: 아스플로, 한국IR협회의 기업리서치센터

아스플로 지역별 매출액 추이



자료: 아스플로, 한국IR협회의 기업리서치센터

베트남 법인은 해산 결정 후
청산 중, 중국 쑤저우 법인은
신공장 건설 중

2025년 연말 기준 아스플로의 연결 대상 종속기업으로는 베트남 법인 ASFLOW VINA CO.,LTD.(지분율 100%)와 중국 법인 Asflow Semiconductor Technology(Suzhou) Co.,Ltd.(지분율 100%)가 있다. 베트남 법인은 피팅·밸브용 가공 부품의 원가 경쟁력 확보를 위해 2017년 8월 설립되었으나, 수년간 이어진 금리 상승과 반도체 업황 둔화로 영업손실이 지속되면서 2025년 중 해산이 결정되어 현재 청산 절차가 진행 중이다. 베트남 법인은 2025년 당기순손실 17.7억원을 기록했으며, 관련 자산은 매각예정자산으로 분류되었다.

중국 법인은 2023년 8월 저장(Zhejiang)성에 설립했던 기존 법인을 2024년 11월 청산하고, 같은 해 쑤저우(Suzhou)시에 신규 설립한 생산법인이다. 현재 건설 중인 신규 공장은 완공 이후 파이프와 튜브 등 시공용 부품을 중점적으로 생산할 예정이다. 중국 법인은 가동 초기임에도 2025년 당기순이익 4.6억원의 흑자를 기록했다. 중국은 반도체 부품의 현지 조달을 정책적으로 요구하고 있어, 회사는 현지 생산체제를 기반으로 중국 시장을 공략할 계획이다.

주요 기술 및 제품

반도체 제조 공정에서 빠질 수 없는 가스

반도체 제조 공정에서는 다양한 가스가 이용된다. 클린룸 환경을 유지하기 위한 가스, 웨이퍼의 산화막을 제거하기 위한 가스, 웨이퍼에 실리콘을 증착하기 위한 가스 등 다양한 가스가 있다. 이러한 가스는 가스 공급소에서 출발하여, 반도체 Fab의 가스정제기와 가스분배기를 거친 뒤 클린룸으로 공급된다. 클린룸 내부에서는 식각, 증착, 세정 등 다양한 공정 장비에 가스가 투입되어 웨이퍼 가공이 이뤄지며, 가스의 순도가 반도체 수율에 직접적인 영향을 미친다.

배관 부품의 핵심은 높은 순도와 매끈한 표면

아스플로는 반도체 공정에서 사용되는 가스를 이송하는 배관 부품(고청정 파이프/튜브, 피팅, 밸브/레귤레이터, 디퓨저/필터 등)을 제조, 판매하고 있다. 반도체 시설에서는 반응성이 높은 화학 가스들이 배관 부품을 통과하기 때문에, 배관 부품의 순도와 내부 표면 처리가 중요하다. 특히, 반도체 공정이 선단화 되면서 미세한 파티클(Particle)로 인한 수율 문제가 더욱 민감해지고 있다. 이때, 배관 부품의 순도가 낮거나 내부 표면이 깔끔하지 않은 경우에는 배관 내부가 화학 가스의 이동으로 마모될 수 있고, 불순물이 화학 가스에 섞이게 되어 반도체 수율 문제로 이어질 수 있다. 따라서, 불순물을 최소화할 수 있는 배관 부품과 불순물을 걸러줄 수 있는 필터의 기술이 중요하다.

아스플로는 금속 표면을 전기화학적으로 처리해 미세한 불순물과 거친 표면을 제거하는 전해연마(EP) 기술과, 고순도 가스를 일정한 양과 압력으로 공급하는 기술 등 4대 핵심 기술을 통해 반도체 가스 배관에 필수적인 초고순도(Ultra High Purity; UHP) 부품을 생산하고 있다. 다만, 파이프/튜브, 밸브/레귤레이터 등의 제품을 직접 생산하는 것은 아니며, 이들 제품을 원재료 형태로 매입한 뒤 전해연마 등의 후처리를 통해 부가가치를 창출한다.

전해연마는 금속 표면을 전기화학적 방법으로 매끈하고 광택 있는 상태로 가공하는 공정이다. 이를 통해 표면 청정도가 향상되고, 부식이 시작될 수 있는 미세 결함이 줄어들어 내식성이 개선된다. 전해연마는 금속을 산성 전해액에 담근 후 전류를 흘려보내 미세한 돌출부와 결함을 용해시키는 방식으로 진행된다. 표면을 물리적으로 깎아내는 기계 연마(Mechanical Polishing; MP)와 달리, 흠집이나 스크래치 없이 표면의 평탄화가 가능하다.

전해연마의 원리 자체는 간단하면서도 효과가 크기 때문에, 기술적인 장벽이 크지 않다고 느낄 수 있다. 그러나 실제로는 기술적인 장벽 이상으로 경험적인 장벽을 무시할 수 없다. 전해연마를 거친 파이프/튜브의 표면 거칠기(Roughness Average, Ra)는 약 0.25 μ m 수준으로, 이는 사람 머리카락 두께의 약 1/300~1/400에 해당한다. 즉, 튜브 표면에 머리카락 하나를 300~400등분하여 그 중 1조각 두께만큼만 울퉁불퉁함이 남아 있는 것이다. 전해연마의 품질은 전해질의 종류와 농도, 전류의 크기와 시간 등 다양한 변수에 의해 크게 좌우된다. 따라서 오랜 경험과 반복된 실험으로 최적의 조건을 구축하는 것이 필수적이다.

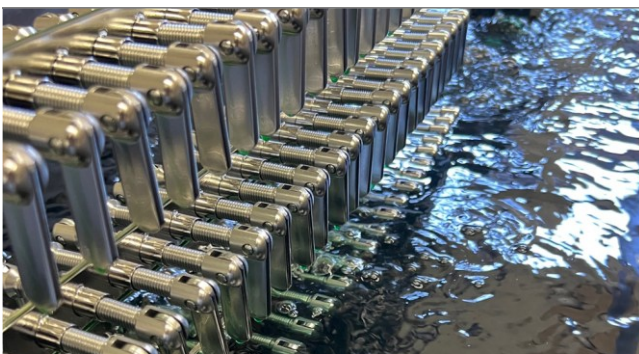
또한 표면 거칠기가 요구 수준을 만족하더라도, 반도체 장비별로 요구되는 특성이나, 장비 내 장기간 품질 유지 요건을 충족하기 위해서는 기술력 이상으로 납품 경험과 장비별 이해가 필요하다. 이처럼 반도체 시장에서는 경험적 노하우가 기술력만큼이나 중요한 경쟁력이 된다. 아스플로는 이미 2018년부터 반도체 장비사에 샘플이나 데모, OEM 등으로 부품을 납품해오며, 품질 인증과 준비를 해왔고, 그 결과 현재는 국내외 주요 반도체 장비사에 품질 인증이 완료된 상황이다.

아스플로 4대 핵심 기술

1. 극청정 표면 처리 기술	직경 수 mm~수십 mm, 길이4m, 6m의 협소하고 긴 튜브 혹은 파이프 소재 내벽에 잔존하는 오염물질, 결합, 미세 흠집 등을 완벽히 제거하여 거울처럼 깨끗하게 고정정 강관으로 만드는 기술
2. 고정정 가공 기술	반도체 공정에 사용되는 고순도 가스가 일정한 양과 압력으로 공급되도록 설계하는 기술 1m ² 당 수 kg에서 수백 kg에 이르는 높은 압력으로 들어오는 고순도 가스를 균일한 압력으로 정량 공급해주는 첨단부품에 적용
3. 나노 입자 여과 기술	초미세 스테인레스 스틸금속분말로 수 nm급 입자를 제거할 수 있도록 금속분말의 양, 크기, 필터 두께 등을 설계하는 기술. 수급 입자가 여과되면서 유량을 증대시킬 수 있는 다층구조 설계기술
4. 고정밀 용접 기술	복잡한 형상의 금속 부품을 불순물 유입 없이 접합하는 기술

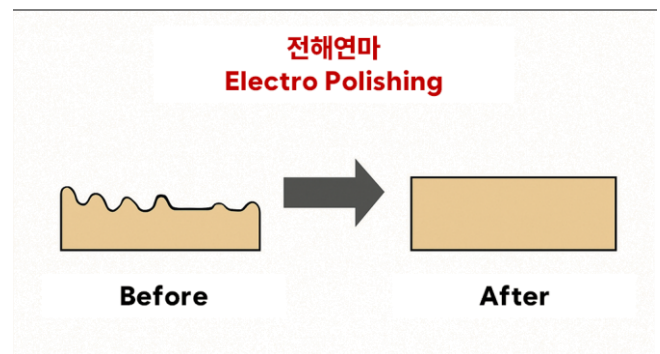
자료: 아스플로, 한국IR협회의 기업리서치센터

연마(Electro Polishing)



자료: VP Metall AS, 한국IR협회의 기업리서치센터

전해연마 전후 비교



자료: Chat GPT, 한국IR협회의 기업리서치센터

[튜브/파이프 - 2025년 매출액 380억원, 매출 비중 56.0%]

튜브/파이프는 아스플로의 핵심 제품으로 반도체 Fab 시공 현장에 주로 납품하고 있다. 튜브/파이프는 웨이퍼 제조 공정에 사용하는 가스를 가스 공급원으로부터 제조 공정 장비까지 이송해주는 부품이다. 2025년 튜브/파이프 매출액은 380억원으로 전년대비 8.5% 감소했으나, 최근 5년간(2020~2025년) 연평균 14.4% 성장하며 전사에서 가장 안정적인 실적을 유지해 온 주력 제품군이다. 2026년 상반기에는 매출액 337억원(매출 비중 56.1%)을 기록하며 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스에 튜브를 납품하는 기업은 아스플로, Valex(미국), Kuze(일본), WSG(한국) 등이 있으며, 극청정 튜브의 경우 아스플로와 Valex가 60% 이상을 공급하고 있다.

반도체 제조 공정이 미세화되면서, 식각(Etch), 증착(Deposition), 세정(Clean) 등 각 단계에서 사용되는 가스 종류와 사용량이 늘어나고 있어 가스 공급라인이 대형화되고 있다. 이러한 추세에 맞춰 아스플로는 기존 50A 이하의 중구경 제품 라인업에서 65A~600A 대구경을 포함하는 제품으로 확대하기 위해 2020년 본사 및 제1공장을 이전하며, 생산 시설을 확충했다.

[피팅 - 2025년 매출액 131억원, 매출 비중 19.3%]

피팅은 주로 가스 공급에 사용되는 금속 소재 튜브와 파이프를 연결하는데 필요한 부품이다. 피팅의 경우 이미 국내에 많은 기업들을 통해서 국산화가 빠르게 이뤄졌고, 많은 기업들이 국내 반도체 기업의 공급사로 등록되어 있다. 주요 경쟁 업체는 태광후지킨, 하이록코리아, 유니락 등이 있다. 2025년 피팅 매출액은 131억원으로 전년대비 15.3% 감소했다. 국산화가 일찍부터 진행되어 경쟁 강도가 높은 품목인 만큼, 업황 부진 국면에서 단가, 물량 양면의 압박을 받는다.

[밸브/레귤레이터 - 2025년 매출액 123억원, 매출 비중 18.1%]

밸브는 가스가 흐르거나 멈추도록 조작하는 부품이고, 레귤레이터는 가스가 일정한 압력으로 흐르도록 조작해주는 부품이다. 주요 경쟁 업체로는 태광후지킨, 유니락 등이 있다. 아스플로는 밸브/레귤레이터 부문에서 경쟁 기업 대비 후발 주자지만 빠르게 제품 라인업을 확보하면서, 매출을 확대할 수 있었다. 최근 반도체 가스 공급 라인 대형화에 따라 대 구경에 적합한 밸브와 레귤레이터를 개발해 제품 라인을 확대하고 있다.

2025년 매출액은 123억원으로 전년대비 37.0% 감소하며 제품군 중 부진이 가장 컸으나, 2026년 상반기 매출액은 139억원으로 상반기에만 전년수준을 상회했다. 최근 5년간(2020~2025년) 연평균 15.0% 성장하며 후발주자임에도 라인업을 빠르게 확대해왔다.

[디퓨저/필터 - 2025년 매출액 45억원, 매출 비중 6.6%]

디퓨저는 진공 장비의 진공 해제 시 장비 내부로 유입되는 가스가 일부 영역에 집중되지 않도록 확산해주는 부품이다. 공정 장비 내부에 진공 상태가 유지되다가, 진공이 해제될 때, 가스가 한번에 몰려들면 장비에 충격을 줄 수 있다. 이때 디퓨저가 가스 흐름을 분산시키고, 완화하여 장비의 안정성을 높인다.

필터는 반도체 소자를 생산하는 장비에 미세 입자가 유입되지 않도록 막아주는 부품으로, 아스플로는 2012년부터 10년간 반도체 공정용 필터 국산화 개발을 시작했다. 2019년부터 국산 필터 제품을 시장에 공급하고 있으며 2021년 일본 반도체 부품기업인 C사에 가스켓 필터 제품 공급을 시작했다. 아스플로의 필터는 주로 반도체 시설의 가스정제기 등에 주로 사용된다. 필터의 주요 경쟁 업체로는 Mott(미국), Pall(미국), Entegris(미국), Nippon Seisen(일본) 등이 있으며, Mott, Pall, Entegris가 국내 필터 시장의 70% 이상을 점유하고 있다.

2025년 디퓨저/필터 매출액은 45억원으로 전년대비 36.4% 감소했으나, 최근 5년간(2020~2025년) 연평균 13.4% 성장해왔다. 디퓨저/필터는 현재까지 해외 주요 기업들이 독점 공급하고 있어 높은 가격대가 유지되고 있는 제품군이며, 아스플로는 해외 반도체 장비용 부품 공급사로부터 공동 개발 요청을 받아, 이를 개발 및 생산을 진행하고 있다.

아스플로 튜브/파이프



자료: 아스플로, 한국R협의회 기업리서치센터

아스플로 피팅



자료: 아스플로, 한국R협의회 기업리서치센터

아스플로 밸브/레귤레이터



자료: 아스플로, 한국R협의회 기업리서치센터

아스플로 디퓨저/필터



자료: 아스플로, 한국R협의회 기업리서치센터

시공용 제품 포트폴리오 확대 및 장비용 시장 진입의 초입

그동안 아스플로는 반도체 공정에 필요한 화학 가스를 가스 저장소에서 반도체 장비용 가스 공급장치까지 이송하는 중 소구경 시공 부품을 주력으로 납품해왔다. 그러나 중소구경 시공 부품을 매출 확대에 한계가 있는 만큼, 아스플로는 대구경 시공 부품으로의 확장을 꾸준히 준비해왔다. 2024년에는 400A급 UHP(초고순도) 강관을 개발하는 데 성공했으며, 이를 기반으로 향후 대구경 시공 부품 납품을 본격화할 계획이다.

다만, 반도체 시공 부품은 일단 설치가 완료되면 교체 수요가 거의 발생하지 않기 때문에, 대구경 시공 부품의 납품을 확대하더라도, 시공 시장만으로는 지속적인 매출 성장이 제한적일 수밖에 없다. 반면, 반도체 장비용 배관 부품 시장은 장비 수명 주기나 공정 변화에 따라 교체 수요가 꾸준히 발생하기 때문에, 시장 규모도 시공 시장 대비 5~10배 이상 크다. 또한, 장비용 부품은 시공용 부품보다 훨씬 높은 수준의 품질 관리가 요구되기 때문에, 이익률 역시 더 높게 형성되어 있다.

아스플로는 이러한 장비용 시장 진입을 목표로 국내외 주요 반도체 장비사에 샘플 부품을 납품하거나, OEM 형태로 꾸준히 부품을 공급해왔다. 이러한 노력을 바탕으로, 현재는 주요 반도체 장비사들로부터 품질 인증을 획득한 상황이다. 실제로 2026년 1분기부터 '모듈'이 신규 매출 품목으로 공시되며, 상반기 누적 기준 매출 24억원(매출 비중 4.1%)을 기록했다. 반도체 장비업체 대상으로 모듈 제품 공급이 시작되었으며, 이는 장비용 시장 진입의 초입으로 판단한다.

아스플로 주요 제품 및 확대 분야



자료: 아스플로, 한국IR협회의 기업리서치센터

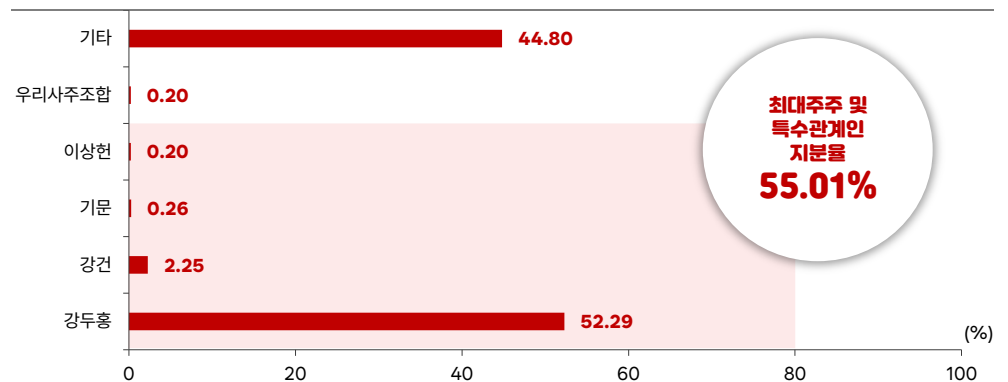
3 주주 구성

2026년 6월 말 기준 아스플로의 총 발행주식수는 13,334,739주이다. 최대주주인 강두홍 대표이사는 6,973,350주로 52.29%의 지분을 보유하고 있으며, 특수관계인을 포함한 합산 지분율은 55.01%이다. 아스플로는 2001년 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 최대주주가 변동된 이력이 없다.

2026년 2분기 중 강두홍 대표이사의 보유 주식 20만주가 자녀인 강건에게 이전되며 대표이사 개인 지분율은 53.79%에서 52.29%로 하락했다. 강건의 지분율이 0.75%에서 2.25%로 확대되어 특수관계인 합산 지분율은 55.01%로 변동이 없다.

아스플로는 2026년 1월 보유 자기주식 409,949주(발행주식의 3.07%)를 전량 장의 처분했다. 처분 목적은 신규사업 투자 자원 확보로 공시되었으며, 이에 따라 현재 보유 자기주식은 없다. 우리사주조합은 26,340주(0.20%), 소액주주는 11,283명이 4,138,017주(31.03%)를 보유하고 있다.

아스플로 주주 구성(2Q26말 기준)



자료: 아스플로, 한국IR협회의 기업리서치센터



산업 현황

1 국내 반도체 시공용 시장은 삼성전자와 SK하이닉스의 CAPEX가 핵심

반도체 부품 시장은

1) 반도체 시공용

2) 반도체 장비용

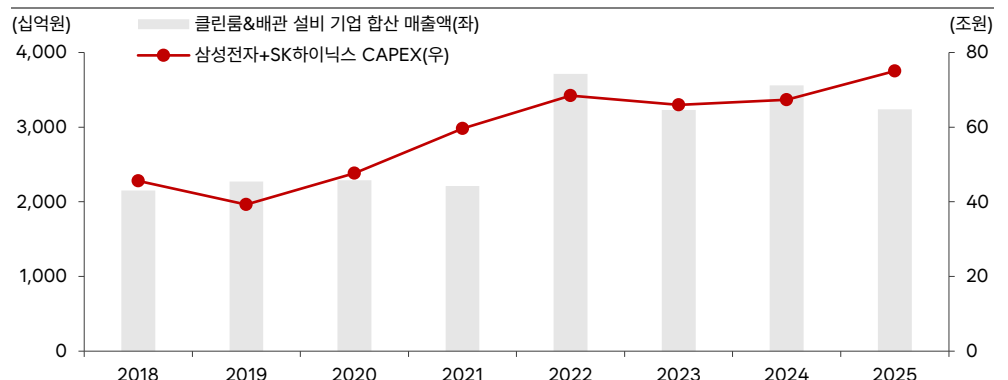
반도체 배관 부품은 크게 1) 반도체 설비 시공에 쓰이는 시장과 2) 반도체 공정 장비에 쓰이는 시장으로 나눌 수 있다. 반도체 Fab 내부 청정도를 유지하게 하는 클린룸, 반도체 가스들의 청정도와 분배를 담당하는 설비인 가스정제기와 가스분배기, 이러한 가스를 이동시켜주는 배관 부품들 모두 반도체 시공용 시장에 포함된다. 공정 장비에 사용되는 부품들은 반도체 Fab 기업에 직접 납품하는지, 아니면 장비사로 납품하는지에 따라 각각 애프터마켓과 비포마켓으로 구분된다.

반도체 시설용 부품 매출액은 전방 파운드리 기업 CAPEX 영향을 크게 받음

반도체 시설용 부품이나 배관 설비는 파운드리와 가동률보다 전방 파운드리 기업의 CAPEX(Capital Expenditures; 자본적 지출: 기업의 미래 이윤 창출을 위해 지출하는 비용을 의미)의 영향을 크게 받는다. 또한 시설용으로 납품되는 부품이나 설비 등은 반도체 공정용 장비, 부품과 달리 교체 수요가 크지 않아, 새롭게 건설되는 Fab에 납품하는 비중이 높다는 특징을 가지고 있다. 국내 반도체 시공 시장은 삼성전자와 SK하이닉스 신규 Fab 투자와 CAPEX 규모에 큰 영향을 받고 있다.

2020년 코로나19 팬데믹 이후 재택근무와 온라인 활동이 확산되면서 PC와 서버 수요가 증가했고, 이에 힘입어 2021년 국내 반도체 기업들은 호실적을 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스는 2021~2022년 CAPEX를 꾸준히 확대했으며, 그 덕분에 2022년 국내 클린룸&배관 설비 기업들의 매출액도 큰 폭으로 증가했다. 2022년 하반기부터 2023년까지 이어진 반도체 업황 부진 속에서 SK하이닉스는 투자 규모를 크게 줄였으나, 삼성전자가 오히려 투자를 늘리면서 합산 CAPEX는 크게 감소하지 않았고, 시공 분야 기업들의 매출액도 소폭 감소에 그쳤다. 이후 2024년 HBM 등 AI 반도체 수요 증가로 SK하이닉스가 CAPEX를 다시 확대하면서 시공 분야 기업들의 매출액은 전년 대비 회복세를 보였다.

삼성전자와 SK하이닉스의 CAPEX에 따른 반도체 시설 관련 기업들 매출액



주: 클린룸&배관 설비 매출액은 한양이엔지, 신성이엔지, 성도이엔지, 세보엠이씨, 케이엔솔, 케이씨의 클린룸 및 배관 설비 매출액의 합산

자료: 각 사, FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

다만 2025년에는 SK하이닉스의 투자 확대에 힘입어 합산 CAPEX가 사상 최대 수준으로 늘었음에도, 클린룸&배관 설비 기업들의 매출액은 이를 따라가지 못했다. 투자 증가분이 신규 Fab 건설이 아닌 HBM 라인 전환과 신규 장비 반입에 집중되었기 때문이다. 이러한 전환 투자는 기존 클린룸 공간 안에서 이루어지는 만큼 클린룸 신축이나 배관 시공 물량으로 이어지지 않는다. 시공 분야 매출은 팜 투자의 초기 단계인 클린룸&배관 공사에서 발생하고 CAPEX 금액의 대부분은 마지막 장비 단계에서 집행되므로, 시공 기업의 실적을 가늠하는 선행지표는 CAPEX 총액이 아니라 신규 팜 착공 여부다. 용인 클러스터 등 신규 현장이 클린룸&배관 공사 단계에 진입하는 시점부터 시공 분야 기업들의 매출은 재차 증가세로 전환될 전망이다.

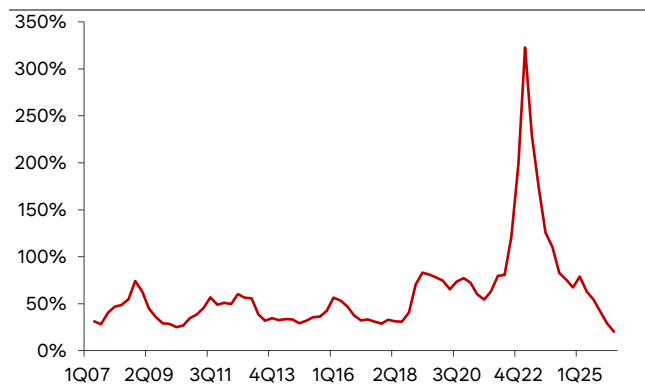
역대급 반도체 호황에 더불어 전례 없는 신규 Fab 장기 투자 사이클 기대

2023년은 반도체 역사상 유례없는 침체 시기

AI 투자 사이클에 따라서, 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 대규모 신규 Fab 투자가 장기간 지속될 것으로 전망한다. 이 과정에서 국내 반도체 클린룸과 배관 공사 등을 진행하는 반도체 설비 인프라 기업들의 장기 성장을 기대한다.

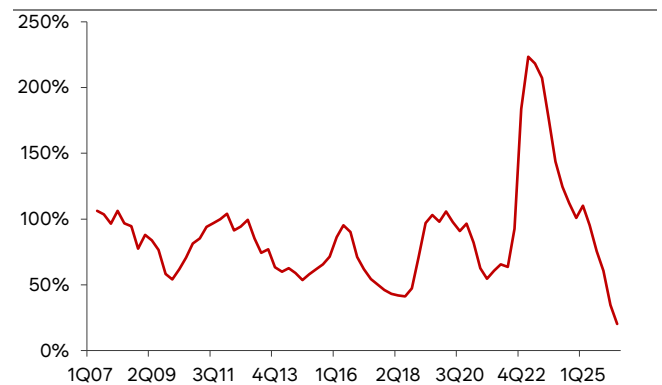
현재 메모리 반도체는 슈퍼사이클에 진입했다고 판단한다. '평균재고자산/매출액' 지표를 통해서도 이런 상황이 명확히 드러난다. 순수 메모리 반도체 업체인 SK하이닉스와 마이크론의 '평균재고자산/매출액' 지표는 2023년 반도체 최악의 침체 시기를 건너, 두 기업 모두 1Q26 기준 20%로 재고 비율이 급락했다. 이는 과거 2016~2018년 클라우드 서버 사이클, 2020~2021년 코로나 사이클 시기의 SK하이닉스와 마이크론 각각의 비율 저점이었던 29%, 41%와 비교했을 때도 확연히 차이가 나는 것을 확인할 수 있다.

SK하이닉스 평균재고자산/매출액



자료:FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

마이크론 평균재고자산/매출액



자료:FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

인텔을 제외한

국내외 반도체 기업

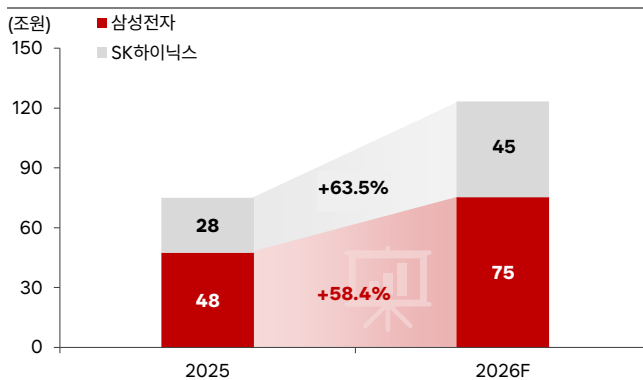
CAPEX 확대 전망

반도체 업황이 개선됨에 따라, 국내외 반도체 기업들의 CAPEX도 전년대비 증가할 것으로 예상된다. 삼성전자의 경우 별도의 연간 투자 가이드언스를 제시하지 않았으나, 분기 CAPEX 집행 금액이 뚜렷한 증가 추세를 보이고 있다. 삼성전자의 시설투자는 2026년 상반기 누적 31.2조원이다. 올해 연간 75조원 투자가 예상되는 만큼, 2026년 하반기 P4의 페이스4, 페이스2 증설이 가속화될 것으로 전망한다. 또한 2027년부터는 P5 증설이 예상되고 있어, 이러한 투자 증가 흐름이 꾸준히 이어질 것으로 전망한다.

또한 SK하이닉스의 경우 1Q26 컨퍼런스콜에서 M15X 램프업, 용인 클러스터 중심의 인프라 준비, EUV 등 핵심 장비 확보로 올해 투자 규모가 전년 대비 크게 증가할 것이라고 밝혔고, 2Q26 컨퍼런스콜에서 올해 CAPEX로 40조원 후반 수준을 예상한다고 밝혔다. SK하이닉스는 2026년 상반기 18.3조원을 투자했으며, 올해 연간 45조원의 투자가 예상되어 삼성전자와 마찬가지로 하반기로 갈수록 투자가 가속화될 것으로 전망한다. 특히, SK하이닉스는 단기 공급 대응력 제고를 위해 M15X(청주) 양산 일정을 앞당기고, 2027년 초 용인 1기 팹 클린룸 오픈 이후 생산능력을 신속히 확대할 수 있도록 투자를 진행할 것이라 밝혔다. 여기에 추가적으로 첨단 패키징 공장 P&T7과 신규 낸드 생산기지 M17, 용인 2기 팹 등 중장기 투자 계획되고 있어, 마찬가지로 장기적인 신규 fab 투자가 이어질 것으로 기대한다.

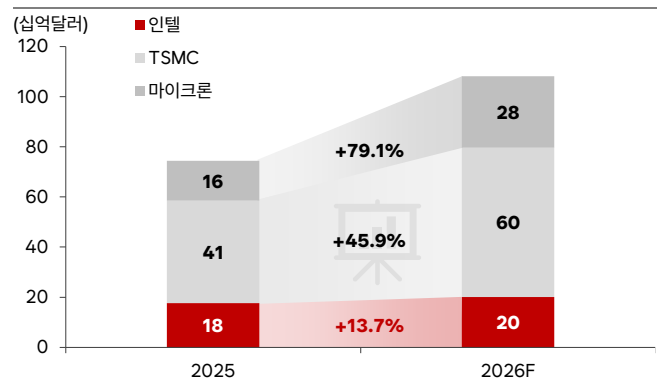
마이크론의 경우 HBM 공급을 확대하기 위해 공격적으로 CAPEX를 늘리며, 2026년 약 280억달러(약 39조원)를 투자할 것으로 전망된다. 이는 전년대비 71.9%나 증가한 수치이다. 2026년 투자금의 상당 부분을 HBM 관련 투자에 사용할 것으로 밝혔으며, 신규 팹 건설, 후공정과 연구개발 투자를 포함하고 있다. TSMC의 경우 2026년 연초에 CAPEX 가이드언스를 대폭 상향했으며, 이에 따라 600억달러(약 84조원)를 투자할 것으로 전망된다. 인텔의 경우 비용 절감 기조에서 투자 확대로 방향을 전환하고 있다. 연초 대비 계획을 늘리며 200억달러 이상으로 CAPEX 가이드언스를 상향했다. 또한 인텔은 투자에 필요한 현금을 마련하기 위해 2026년 8월 10일 대규모 유상증자를 발표했다. 발행 규모는 당초 발표한 150억달러에서 200억달러로 증액되었으며, AI 수요에 대응하기 위한 팹, 장비 투자 확대와 마이너스인 잉여현금흐름을 메우기 위한 선제적인 자금 확보라고 밝혔다.

국내 반도체 기업 2026년 CAPEX 전망



자료:FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

해외 반도체 기업 2026년 CAPEX 전망



자료:FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

삼성전자, SK하이닉스 Fab 증설 일정

※ 색상 진하기는 시점을 나타냄 (진할수록 가까운 시점). 확정 일정 기준이며 기존 계획은 미표기.

캐파 증설 (월 웨이퍼 투입 기준)

신규 팹 오픈 · Fab-in

		2H25	1H26	2H26	1H27	2H27	2028
삼성 전자	P4 평택 · 램프업	Phase 1 DRAM 30K · NAND 15K	Phase 3 DRAM 50K	Phase 4 DRAM 50K	Phase 2 DRAM 50K		
	P5 평택 · 신규					P5 Fab-in 2027년 12월	
	P6 평택 · 신규						P6 Fab Open 2028년 하반기
SK 하이닉스	M15X 청주 · 램프업		Phase 1 DRAM 40K	Phase 2 DRAM 40K			
	Y1 용인 · 신규				Y1 Fab Open 2027년 5월		
	Y2 용인 · 신규						Y2 Fab Open 2028년 하반기

자료: 언론 종합, 한국IR협회의 기업리서치센터



투자포인트

1 아스플로 장비 부품&모듈 시장 진입 초입!

**2026년은 아스플로의 이뤄지지
않던 꿈인 장비용 배관 납품이
이뤄지는 원년이 될 것**

반도체 업황 회복에 따라 그동안 아스플로의 장비용 시장 진입을 가로막고 있던 요소들이 해소되면서 본격적으로 장비용 시장에 부품을 납품하며, 고성장이 이어질 것으로 기대한다. 아스플로의 반도체 장비용 매출 증가는 곧, 시공용 부품 시장의 높은 매출 변동폭이 축소됨을 의미하고, 향후에도 안정적인 매출 흐름을 보일 수 있게 될 것으로 전망한다. 또한 장비용 부품&모듈은 기존 시공 부품 대비 이익률이 2배 이상 높아, 매출과 이익 모두 개선되는 흐름을 기대한다.

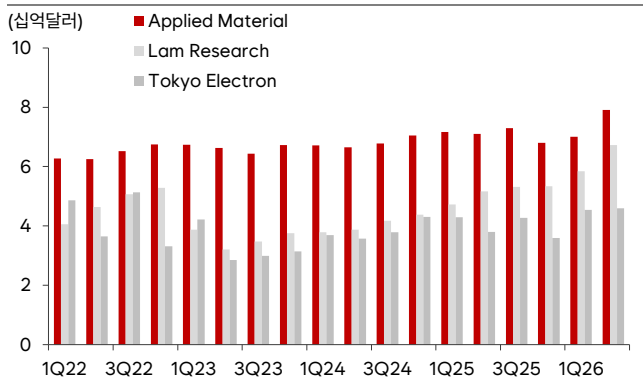
시공 부품 시장은 글로벌 약 1~2조원 규모인 반면, 장비 부품 및 모듈 시장은 시공 부품 시장의 5~10배 수준으로 추정된다. 반도체 장비 부품의 경우 가동 중에 주기적으로 교체되며, 애프터마켓이 별도로 형성된다는 점이 결정적인 시장 규모의 차이로 이어진다.

아스플로는 2018년 어플라이드 머티리얼즈의 OEM 공급사 등록을 시작으로, 2022년 어플라이드 머티리얼즈의 반도체 장비용 제품 품질 인증 절차를 진행했고, 같은 해 램리서치에도 벤더로 등록 완료되었다. 또한 2022년 OEM으로 일본의 C, J사에 부품 공급 등을 진행하며, 레퍼런스를 쌓아왔으며, 주요 장비사의 품질 인증은 수년 전에 확보했다.

**2023년 반도체 장비용 배관
부품의 핵심 수요자인 램리서치와
도쿄일렉트론의 매출 급감**

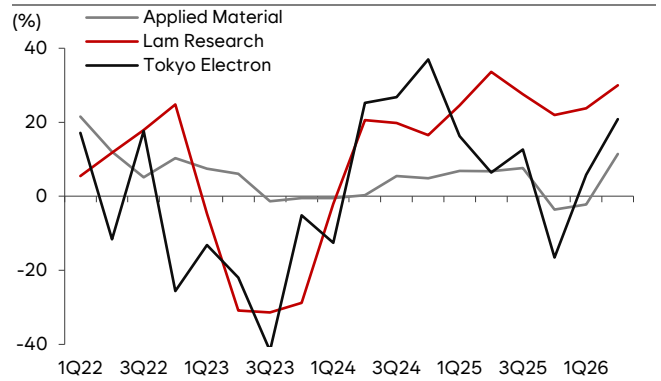
당초 아스플로의 목표였던 2023년 장비용 시장 진입은 기대와 다르게 지속적으로 연기되었다. 가장 주된 이유로는 2023년부터 이어진 메모리 반도체 다운 사이클 때문이다. 2023~2025년 다운사이클 국면에서 장비사 발주가 줄자 기존 배관 부품 벤더가 보유 재고를 소진하며 대응했고, 아스플로와 같은 후발 벤더에게 배분될 물량 자체가 존재하지 않았다. 실제로 배관 부품 수요를 확인할 수 있는 지표인 램리서치와 도쿄일렉트론의 2023년 매출은 크게 감소했다. 양사의 주력 제품인 식각 및 증착 장비가 3D NAND, DRAM 등 메모리 공정용 매출 비중이 높기 때문이다.

글로벌 반도체 장비사 분기별 매출액 추이



주: 분기별 매출액은 달러 기준
(어플라이드 머티리얼즈 결산월: 10월, 램리서치 결산월: 6월, 도쿄일렉트론 결산월: 3월)
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

글로벌 반도체 장비사 분기별 매출액 YoY 성장률 추이



주: 분기별 매출액 성장률은 달러 기준
(어플라이드 머티리얼즈 결산월: 10월, 램리서치 결산월: 6월, 도쿄일렉트론 결산월: 3월)
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

아스플로의 장비향 매출액은 램리서치를 중심으로 확대될 것으로 전망

아스플로의 장비향 매출은 램리서치를 중심으로 확대될 것으로 전망한다. 아스플로의 램리서치향 매출액은 2025년 약 30억원 수준이었으나, 연초에만 2배 이상의 물량이 확정되었다. 현재 아스플로는 램리서치를 대상으로 약 1,000여 개 Weldment(용접 배관 조립품) 품목에 대한 제품 승인을 진행했으며, 기 승인된 품목을 중심으로 2026년 3분기부터 일부 양산을 시작해, 2026년 4분기부터 본격적인 양산을 확대할 계획이다. 또한, 아스플로는 램리서치향 가스 블록(Gas Block) 가공 사업 진출을 위해 2026년 9월부터 머시닝 인증(Machining Qualification)을 시작할 계획이다.

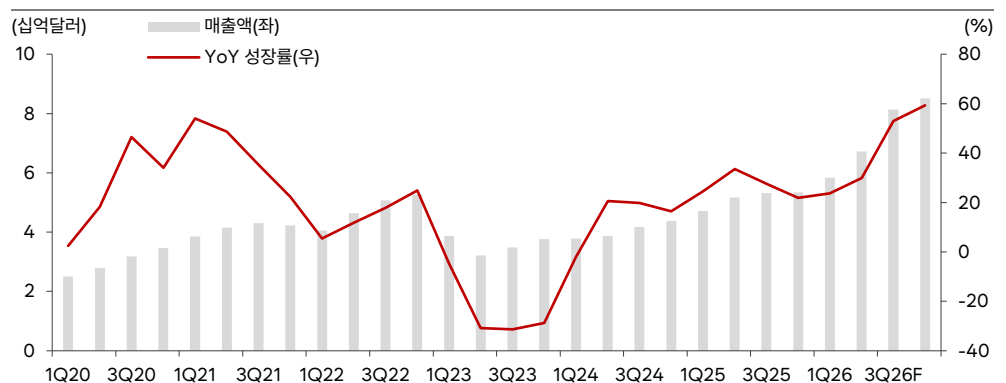
아스플로가 그동안 지연되어 온 램리서치향 제품들의 퀄리피케이션(Qualification)이 동시다발적으로 통과되는 배경에는 AI 수요가 촉발한 반도체 장비 사이클이 장기간 이뤄질 수 있다는 변화 덕분이다. 램리서치는 2026년 WFE(Wafer Fabrication Equipment; 웨이퍼 장비 시장) 전망을 1월 1,350억달러, 4월 1,400억달러, 7월 1,500억달러로 세 차례 상향했으며, 2026년 6월 컨퍼런스에서는 가동률이 사실상 100%에 도달해 더 올릴 여지가 없다고 발표했다.

주목할 점은 램리서치는 이러한 CAPA 부족 상황을 해결하기 위해 말레이시아 2공장 증설과 글로벌 공급망 확대를 통해 해결하려고 하고 있다는 점이다. 램리서치는 생산 확대를 위해서 3월 분기 900명, 6월 분기 1,800명의 인력을 충원했으며, 대부분의 인력이 공장 조립 인원이라고 밝혔다. 기존 아스플로가 램리서치에 공급하던 품목이 튜브, 피팅과 같은 단품에서 Weldment(용접 배관 조립품)와 가스 블록 등으로 확대되고 있는 것도, 기존 벤더만으로 공급이 원활하지 않기 때문으로 추정한다.

특히 반도체 장비용 배관 부품은 벤더 등록이 완료되더라도 제품별로 개별 승인을 다시 받아야 해 실질적인 양산까지 최소 5년 이상이 소요된다. 2023년 이후 이어진 다운사이클 국면에서 장비 부품 업체는 출혈 경쟁을 겪었고, 이 기간 신규 진입 유인이 크게 위축됐다. 결국 단기적으로 벤더 확대는 어려울 것으로 판단하며, 이번 사이클 동안 경쟁 심화 가능성은 제한적일 것으로 전망한다.

이러한 산업적 흐름에 맞춰 아스플로는 본격적으로 CAPA를 확대하고 있다. 머시닝 신공장을 확보하기 위해 2026년 하반기 중으로 정남산업단지 내에 토지 및 건물, 시설 및 기계장치를 취득하기 위해 181억원을 투자할 계획이다. 또한 2027년 3월 쑤저우 공장을 완공할 계획이다.

램리서치 분기별 매출액 및 YoY 성장률 추이 및 전망

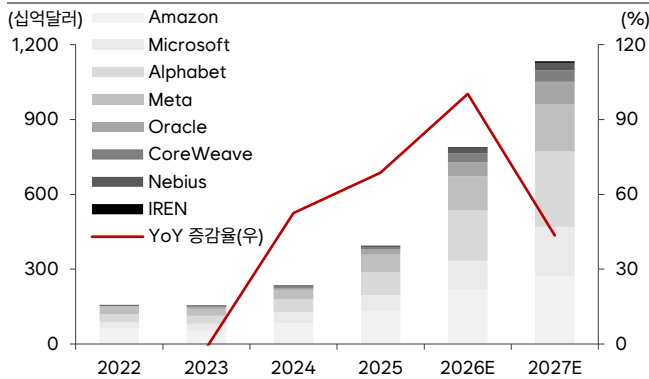


주: 분기별 매출액 및 성장률은 달러 기준(램리서치 결산월: 6월)

자료: 램리서치, 한국IR협회의 기업리서치센터

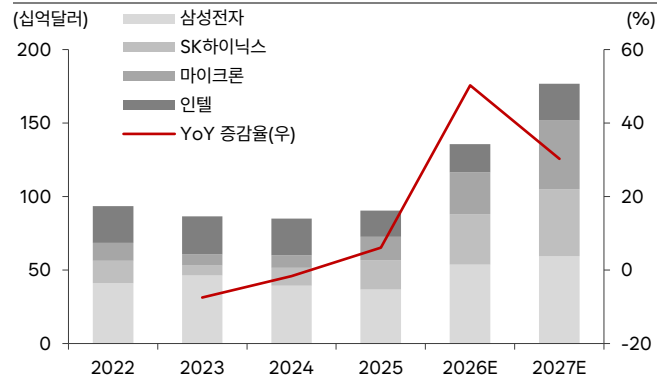
이러한 램리서치 등의 장비사의 투자사이클은 하이퍼스케일러와 네오클라우드 업체들의 CAPEX가 꺾이지 않는 한 지속될 것으로 전망한다. 이들 기업의 CAPEX는 곧 반도체 수요 증가로 이어지며, 결과적으로 글로벌 반도체 칩 메이커 기업들의 CAPEX 증가로 이어지고 있다. 글로벌 반도체 칩 메이커들의 장비 수주 확대는 결국 램리서치와 같은 반도체 장비사들의 수주를 확대시키고 이는 결국 아스플로의 부품 공급 확대로 이어질 것으로 전망한다.

주요 하이퍼스케일러 및 네오클라우드 업체들 CAPEX 추이 및 전망



자료:FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

글로벌 반도체 칩 메이커 CAPEX 추이 및 전망



자료:FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

향후 3년, 시공 물량의 절대 규모가 다르다

고객사 확대로 물량뿐 아니라 단가 협상력도 증가

향후 3년간 아스플로의 시공용 물량은 확대 국면에 진입할 것으로 전망한다. 20년간 삼성전자와 SK하이닉스에 집중돼 있던 고객 기반은 2026년 초 사&M사 진입으로 글로벌 칩메이커 전반으로 넓어졌다. 주목할 점은 이번 사이클에서 물량과 단가가 함께 움직인다는 것이다. 대체 판로 확보로 협상력이 회복되며 2026년 2분기 매출총이익률은 22.6%로 전분기 대비 7.8%pt 개선됐고, 고객사들의 팹 증설 일정이 복수 연도에 걸쳐 가시화되고 있다.

시공 부품 매출을 가능하는 선행지표는 CAPEX 총액이 아니라 신규 팹 착공 여부다. 2025년 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 CAPEX가 사상 최대 수준으로 늘었음에도 클린룸 및 배관 설비 기업들의 매출이 이를 따라가지 못한 것은, 투자 증가분이 신규 팹 건설이 아닌 기존 클린룸 내부의 HBM 라인 전환과 장비 반입에 집중됐기 때문이다.

2026~2028년은 성격이 다르다. 국내는 평택 P4 후속 페이지와 P5, P6가 연속 착공 단계에 진입하고, SK하이닉스는 M15X 램프업에 이어 용인 클러스터 1기 팹 클린룸 오픈이 예정되어 있다. 해외는 삼성전자 테일러 팹, 마이크론과 인텔의 증설이 겹친다.

아스플로에게 이번 사이클의 차이는 고객 기반이다. 과거 시공용 부품 매출은 삼성전자와 SK하이닉스 2개사에 사실상 전량 의존했고, 이는 국내 CAPEX 공백기마다 실적이 급락하는 구조적 원인이었다. 아스플로는 2026년 초 북미 칩메이커 2개사(사&M사) 벤더 등록을 완료했다고 밝혔으며, 사는 3분기, M사는 3~4분기부터 거래가 시작될 것으로 예상된다.

또한 고객 다변화는 물량 이상의 의미를 갖는다. 2023년 이후 국내 칩메이커의 단가 인하 압력과 해외 업체의 저가 공세가 겹치며 시공용 부품 가격은 전년대비 약 30% 하락했고, 이는 2024~2025년 영업적자의 직접적인 원인이었다. 고객 다변화를 기반으로 아스플로는 2026년 시공용 부품 단가를 회복했고, 이에 따라 2분기 매출총이익률은 22.6%로 전분기 14.8% 대비 7.8%pt 개선됐다. 여기에 시공용 내에서도 공정 직전 구간에 적용되는 UHP급의 비중 확대와 대구경 납품 확대도 병행되고 있다.

결국 아스플로는 고객사들의 Fab 착공 사이클, 고객 다변화에 따른 판가 정상화, 고부가 제품 믹스 개선이 2026~2028년에 걸쳐 동시에 작용하며, 과거와 달리 물량과 단가가 함께 증가하는 국면이 장기간 이어질 것으로 전망한다.

주요 칩메이커 신규 Fab 투자 일정

기업	팩 - 위치	일정
인텔	오리건 힐스보로 (18A)	18A 개발 및 파일럿 생산 거점 (2025년 초기 생산 후 양산은 애리조나로 이관)
	애리조나 챌들러 Fab 52 (18A)	2025년 10월 양산 개시 → 2026년 램프업 진행 중, 수율 정상화도는 2027년 초 예상
	애리조나 챌들러 Fab 62 (18A)	2028년경 가동 예정
	오하이오 팩 2개	첫 팩 2030년 완공 → 2031년 가동, 2번째 팩 2031년 완공 → 2032년 가동
마이크론	아이다호 보이시 ID1 (HBM4용 D램)	2027년 중반 가동
	아이다호 ID2	건설 중 → 2028년 말 가동
	뉴욕 클레이 메가팩 (팩 4개)	2026년 1월 착공 완료 → 첫 팩 2030년 말 가동
	일본 히로시마 신팩	2026년 7월 착공 → 2028년 하반기 장비 반입, 2028년 여름 출하 목표
	싱가포르 (HBM 패키징)	2026년 가동 개시 → 2027년 캐파 본격 확대
삼성전자	평택 P4 Ph2 (HBM4 D램 전용)	2026년 11월 초기 가동 (임시사용 승인, 당초 대비 6개월 단축)/ Ph4는 2026년 7월 가동
	평택 P5 Ph1 (HBM4-차세대 D램)	2026년 본공사 진행 중 → 2027년 5월 준공(임시사용) → 이르면 2027년 가동, 전체 라인 2028년
	평택 P5 Fab 2	2026년 7월 착공 → 2029년 상업 가동 목표
	텍사스 테일러 팩1 (2나노 파운드리)	시운전 단계 진입 → 2026년 말 가동 → 2027년 본격 양산
	텍사스 테일러 팩2	2026년 말 착공 → 2030년 양산 목표
	용인 클러스터 (파운드리)	2026년 말 착공 → 첫 팩 2030년 전후 가동 (6기 전체 완공 목표 2047년→2040년 단축)
SK하이닉스	청주 M15X (HBM4용 D램)	2025년 10월 첫 클린룸 오픈 → 2026년 4월 웨이퍼 투입 본격화 → 2027년 월 8만장 램프업
	청주 P&T7 (HBM 패키징)	2026년 4월 본공사 착수 → 2027년 말 클린룸 완공 목표
	용인 클러스터 1기 팩 (차세대 D램HBM)	2027년 2월 클린룸 오픈 (3개월 앞당김, 총투자 31조원으로 확대)
	미국 인디애나 (HBM 패키징)	2026년 8월 27일 착공식 → 2028년 하반기 양산 목표

자료: 언론 종합, 한국IR협의회 기업리서치센터



실적 추이 및 전망

2025년 연간 매출액 679억원(YoY -18.8%), 영업손실 70억원(YoY 적자지속)

2025년 실적 부진의 이유

1) 신규 펌 착공 공백

2) 주요 제품 평가 하락

2025년 연간 매출액 679억원(YoY -18.8%), 영업손실 70억원(YoY 적자지속)을 기록했다. 사업부문별 매출액은 튜브/파이프 380억원(YoY -8.5%), 피팅 131억원(YoY -15.3%), 밸브/레귤레이터 123억원(YoY -37.0%), 디퓨저/필터 45억원(YoY -36.4%)으로 구성된다. 지역별 매출액은 국내 442억원(YoY -20.7%), 중국 129억원(YoY +52.8%), 일본 75억원(YoY -31.4%), 기타 33억원(YoY -61.0%)으로 구성된다.

2025년 실적 부진의 배경은 신규 펌 착공 공백과 그에 따른 평가 하락이다. 아스플로의 시공용 배관 부품은 펌 신축 시점에 집중 투입되는 구조로, 칩메이커의 CAPEX 총액보다 신규 클린룸 착공 여부에 매출이 연동된다. 2025년 국내 투자는 신규 펌 건설보다 기존 라인의 HBM 전환과 장비 반입에 집중됐고, 그 결과 시공용 배관 수요 자체가 위축됐다. 제한된 물량을 두고 경쟁이 격화되면서 국내 칩메이커의 단가 인하 압력이 강화됐고, 국내에 진출한 미국&일본계 업체까지 저가 공세에 가담했다.

2025년 매출총이익률은 6.5%로 2024년 12.9% 대비 6.4%pt 하락했다. 특히, 2022년 장비사 진입을 기대하고 선 제적으로 늘렸던 설비 및 인력은 높은 고정비로 작용했고, 결과적으로 매출 하락폭보다 더 큰 폭의 매출총이익 하락으로 이어졌다. 결과적으로 영업손실은 2024년 -19억원에서 2025년 -70억원으로 확대되었다.

2026년 연간 매출액 1,301억원(YoY +91.6%), 영업이익 153억원(YoY 흑자전환) 전망

2026년에는 반대로 작용할 것

1) 신규 펌 착공 가속화

2) 주요 제품 평가 회복

2026년 상반기 누적 기준 매출액 600억원(YoY +46.7%), 영업이익 58억원(YoY 흑자전환)을 기록하며, 연속 7개 분기의 영업적자를 끌어내고, 턴어라운드에 성공했다. 이는 1) 다운사이클 국면에서 30% 가까이 하락했던 시공용 부품 단가를 2026년 2분기부터 원상 복귀시키며, 매출총이익률이 개선되었기 때문이며, 2) 매출액이 46.7% 증가하는 동안, 급여는 4% 증가에 그쳤고, 인건비 비중도 21.4%에서 15.2%로 하락하는 등 고정비 레버리지 효과가 나타났기 때문이다. 특히, 영업이익은 1Q26 14억원, 2Q26 44억원으로 QoQ +219.5% 상승했다. 하반기에도 이러한 영업이익 정상화 기조는 이어질 것으로 전망한다.

2026년 상반기 실적 가운데 주목할 부분은 모듈 사업의 실적 반영이 시작됐다는 점이다. 아스플로는 2020년 A사 OLED 장비용 모듈 공급을 시작으로 조립 사업을 준비해 왔으나, 그간 매출 규모가 미미해 별도 계정으로 구분되지 않았다. 2026년 들어 계정이 분리되면서 1분기 9억원, 2분기 15억원 등 상반기 24억원이 인식됐다. 단품 판매에서 어셈블리 공급으로 사업 확대가 이뤄진 것으로 판단한다.

2026년 아스플로 연간 매출액 1,301억원(YoY +91.6%), 영업이익 153억원(YoY 흑자전환, OPM 11.7%)을 전망한다. 사업부문별 매출액은 튜브/파이프 723억원(YoY +90.1%), 피팅 175억원(YoY +33.3%), 밸브/레귤레이터 271억원(YoY +121.0%), 디퓨저/필터 59억원(YoY +31.6%), 모듈 72억원(신규 사업부문)으로 추정한다.

매출 회복 및 성장은 시공용 판가 회복과 장비항 진입이 동시에 작용한 결과다. 시공용 시장은 2025년의 Fab 착공 공백에서 벗어나는 구간으로 판단한다. 삼성전자는 평택 P4 Ph4가 2026년 7월, Ph2가 11월 가동에 들어가고, P5 Ph1이 본공사 단계에 진입하는 등 클린룸 조성이 순차적으로 진행되고 있다. SK하이닉스 역시 청주 M15X에 이어 P&T7이 2026년 4월 본공사에 착수했으며, 용인 클러스터 1기 Fab은 2027년 2월 클린룸 오픈을 목표로 공정을 3개월 앞당기는 등 투자 일정이 가속화되고 있다.

해외에서도 마이크론이 7월 히로시마 신규 팹을 착공했고, SK하이닉스는 8월 인디애나 착공식을 앞두고 있다. 배관 부품은 클린룸 구축과 장비 반입 사이 구간에 집중 투입되는 만큼, 2026~2027년 중 다수 현장이 동시에 해당 구간을 통과하며 물량이 확대될 것으로 전망한다. 여기에 2026년 초 사와 M사 벤더 등록이 더해지며, 20년간 국내 2개사에 집중됐던 매출처가 다변화되는 첫 해가 될 것으로 기대한다.

장비사 발주 역시 확대 국면으로 판단한다. 램리서치는 2026년 WFE 전망을 1월 1,350억달러에서 4월 1,400억달러, 7월 1,500억달러로 세 차례 상향했으며, 9월 분기 매출 가이드نس로 전분기 대비 20% 성장을 제시했다. 현재 이러한 장비 수요 폭증에 맞춰 램리서치는 상반기 중으로 2,700명의 신규 인력을 충원했으며 대부분 공장 조립 인원으로 확인된다. 이는 외부에서 조달한 부품 조립을 통해 생산을 확대한다는 의미로 배관 부품 협력사의 공급 확대로 이어진다.

아스플로는 램리서치향으로 1분기 하스텔로이 튜브 승인을 획득했으며, 동시에 약 1,000여 개 수준의 Weldment 품목에 대한 승인 절차를 진행하는 등 양산과 제품 인증이 동시다발적으로 이뤄지고 있다. 반도체 장비용 배관 부품은 벤더 등록에 5년 안팎, 이후 품목별 승인에 다시 1~2년이 소요되어 단기간 내 신규 진입이 어려운 영역이다. 수요가 급증하는 국면에서 공급이 즉각 늘어날 수 없는 구조인 만큼, 이미 승인 절차를 밟고 있는 소수 업체에 물량이 집중될 것으로 판단한다. 하반기로 갈수록 장비항 매출 규모는 더욱 확대될 것으로 전망한다.

연간실적 테이블

(단위: 억원, %)

	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	887	869	836	679	1,301
튜브/파이프	376	351	416	380	723
피팅	273	242	155	131	175
밸브/레귤레이터	193	225	195	123	271
디퓨저/필터	43	50	71	45	59
모듈	0	0	0	0	72
영업이익	105	64	-19	-70	153
영업이익률	11.8	7.3	-2.2	-10.3	11.7
당기순이익	91	36	-24	-99	179
당기순이익률	10.2	4.1	-2.8	-14.6	13.8
YoY					
매출액	50.5	-2.0	-3.8	-18.8	91.6
튜브/파이프	28.8	-6.6	18.3	-8.5	90.1
피팅	70.4	-11.7	-35.9	-15.3	33.3
밸브/레귤레이터	93.2	16.6	-13.3	-37.0	121.0
디퓨저/필터	20.8	15.8	41.8	-36.4	31.6
영업이익	164.9	-39.5	적전	적지	흑전
당기순이익	127.6	-60.5	적전	적지	흑전

자료: 아스플로, 한국IR협의회 기업리서치센터



Valuation

시공 부품에서 장비 부품으로, 멀티플 리레이팅은 정당

시공 부품에서 장비 부품사로의 멀티플 리레이팅은 정당

아스플로는 2026F 기준 PER 16.1배, PBR 4.5배(ROE 32.4%)를 형성하고 있다. 현 주가는 아스플로를 시공 부품 기업이 아닌 장비 부품 기업으로 재분류해 평가한 수준이며, 이번 사이클에서 기록할 성장률과 마진 개선 폭을 고려하면 정당화 가능하다고 판단한다. 다만 2026년 순이익 179억원에는 상장주식 처분이익 50억원이 포함되어 있어, 이를 제외한 본업 기준 순이익은 129억원이며 이 경우 PER은 22.4배로 상승한다. 영업외손익의 변동성이 큰 구간인 만큼 P/E 보다 P/B를 중심으로 판단하는 것이 타당하다.

시공 밸류체인과 CKD(일본), Entegris(미국)의 멀티플 차이는 이익률의 절대 수준에서 나오는 것으로 판단한다. 국내 반도체 시공 밸류체인(한양이엔지, 성도이엔지, 세보엠이씨)은 2026년 기준 영업이익률 5.7~7.1%, PBR 0.3~0.7배, ROE 11.3~16.2%에 형성되어 있다. 반면 반도체 제조장비와 팹 설비 내부의 부품을 생산하는 CKD(일본), Entegris(미국)는 각각 2026년 기준 영업이익률 15.3%, 24.2%를 기록하고 있으며, PBR 2.3배, 4.8배의 멀티플을 기록하고 있다. 최근 10년 평균 영업이익률로 보면 격차는 더 뚜렷하다. 한양이엔지 6.6%, 성도이엔지 3.5%, 세보엠이씨 3.4%로 3사 평균 4.5%인 반면 CKD는 9.8%, Entegris는 17.5%로, PBR 순서를 그대로 따라간다.

영업이익률 차이는 사업 구조에서 비롯된다. 시공사는 팹이 완공되면 해당 프로젝트의 매출이 종료되는 도급 구조로, 신규 수주를 확보해야 매출이 유지되며 원가 전가력도 제한적이다. 반면 부품사는 팹 가동 이후에도 교체 및 보충 수요가 이어지고, 고객사 승인(Qualification)을 통과한 품목은 장비 수명 동안 공급이 지속된다. 같은 CAPEX 사이클에서도 시공은 건설 국면에만, 부품은 건설 이후에도 매출이 발생한다는 차이가 마진 수준과 멀티플의 격차로 이어진다.

사업 구조상 아스플로와 가장 유사한 기업은 CKD이나, 부여된 멀티플은 아스플로가 더 높다. CKD는 반도체 팹의 유틸리티 설비부터 공정장비 내부까지 약액, 가스, 진공, 공압 제어 부품을 공급하며, 밸브/레귤레이터 등 단품과 이를 조립한 패널 제품을 함께 판매한다. 시공과 장비를 모두 커버하고 단품에서 모듈로 확장한다는 점에서 아스플로와 사실상 동일한 구조다. 그럼에도 아스플로는 2026F 기준 PBR 4.5배(2026F ROE 32.4%)로 CKD의 2.3배(2026F ROE 12.2%)를 크게 상회한다. 아스플로의 이익률 하단은 2025년 -10.3%로, 같은 기간 흑자를 유지한 국내 시공 3사보다도 낮았다. 이익률의 레벨과 지속성이 아직 검증되지 않은 상태에서 비교 기업 대비 높은 멀티플을 부여받고 있다.

다만 이러한 프리미엄은 이번 사이클에서 아스플로가 기록할 성장률과 마진 개선 폭을 고려하면 정당화 가능하다고 판단한다. 첫째, 아스플로는 기업 성장의 초입이다. 국내 시공 3사의 2026F 매출 성장률은 13.5%(한양이엔지), 16.0%(성도이엔지), 36.9%(세보엠이씨)이며, CKD와 Entegris는 각각 14.1%, 8.7%에 그친다. 반면 아스플로는 2026년이 장비 부품&모듈 시장에 실질적으로 진입하는 첫 해이며, 91.6%의 고성장을 예상한다. 이는 2025년 기저효과를 감안하더라도, 역대 최대 매출을 시현했던 2022년 887억원 대비로도 46.8% 더 높은 매출이다.

둘째, 펌 증설 사이클이 시공 부문의 회복과 장비 진입 확대를 동반할 것으로 기대한다. 삼성전자 펌택 P4&P5와 텍사스 테일러, SK하이닉스 청주 M15X와 용인 클러스터가 2026~2027년에 걸쳐 동시에 진행되며, 해외 칩메이커인 I&M사 벤더 등록으로 고객 기반도 확대됐다. 시공 부품은 착공 시점에 물량 자체를 확대시키고, 장비사항 부품은 단가와 마진 구조가 기존 제품과 상이해 믹스 개선을 통해 GPM을 끌어올린다. 외형 성장과 수익성 개선이 동시에 진행되는 구조이다.

셋째, 결과적으로 아스플로의 이익 수준이 시공사 수준을 벗어난다. 2Q26 영업이익률은 13.9%로 2026F 연간 추정치 11.7%를 상회했으며, 이는 국내 시공 3사의 두 배 수준이자 CKD의 10년 평균 9.8%를 넘어서는 수치다. 2026F ROE 32.4% 역시 시공 3사 평균 14.3%, CKD 12.2%, Entegris 12.8%를 크게 상회한다.

피어테이블

(단위: 십억원, 배, %)

지수 및 기업명	종가 (현지 통화)	시가 총액	매출액		영업이익		P/E		P/B		ROE	
			2025	2026F	2025	2026F	2025	2026F	2025	2026F	2025	2026F
아스플로	21,650	289	68	130	-7	15	N/A	16.1	1.3	4.5	-19.7	32.4
한양이엔지	29,050	508	1,118	1,269	54	89	9.2	6.7	0.6	0.7	6.8	11.3
성도이엔지	7,270	111	743	862	58	61	3.3	2.1	0.3	0.3	10.9	15.4
세보엠이씨	21,600	218	716	980	40	56	4.1	4.7	0.5	0.7	13.9	16.2
산성이엔지	15,780	320	567	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1.4	N/A	N/A	N/A
케이씨	34,200	377	797	N/A	46	N/A	7.7	N/A	0.3	N/A	5.5	N/A
CKD(일본)	5,580	3,298	1,494	1,705	182	261	21.0	18.3	1.9	2.3	9.4	12.2
Entegris(미국)	144	30,372	4,546	4,940	644	1,194	54.4	36.6	3.2	4.8	6.2	12.8

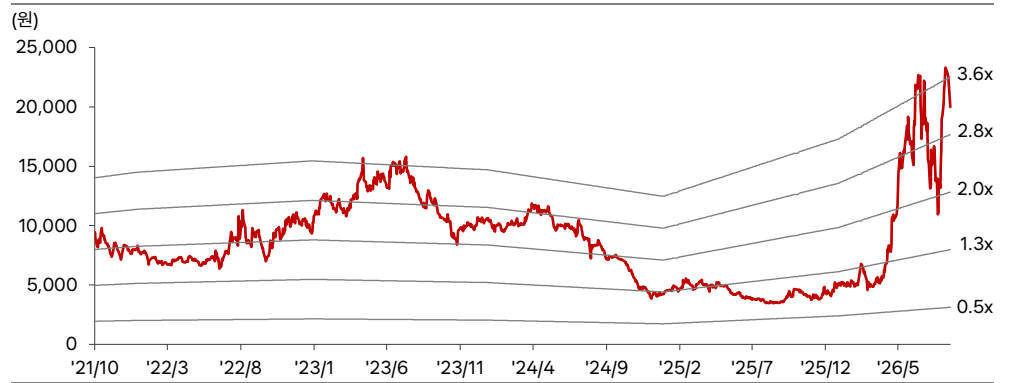
주: 아스플로, 한양이엔지, 성도이엔지는 당사 추정치. 그 외 기업은 시장 컨센서스. 종가를 제외한 시가총액, 매출액, 영업이익은 십억원 기준

자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

현재 아스플로의 PBR은 2022년 하반기와 유사한 밴드 상단부에 위치해 있으나, 그 근거는 기대감이 아니라 실적이라는 점에서 차이가 있다. 아스플로의 PBR 밴드는 세 국면으로 구분된다. 2021년 10월 상장 이후 2022년 상반기까지는 2배 내외에서 형성되었고, 2022년 하반기 램리서치 벤더 등록을 계기로 장비 부품 시장 진입 기대가 반영되며 밴드 상단인 3배 중후반까지 상승했다. 이후 2023~2025년에는 장비향 매출이 실제로 발생하지 않은 채 반도체 다운사이클과 판가 하락이 겹치며 7개 분기 연속 영업적자를 기록했고, 주가는 4,000~5,000원대에서 밴드 하단부까지 디레이팅됐다. 2025년 말 이후 주가가 재차 급등하며 현재는 다시 밴드 상단부에 위치해 있다.

2022년의 밴드 상단은 램리서치와 같은 반도체 장비사 벤더 등록만으로 형성된 멀티플이었고, 이후 3년간 장비향 매출로 유의미하게 연결되지 못하면서 되돌려졌다. 반면 2026년에는 상반기 누적 매출 600억원(YoY +46.7%), 영업이익 58억원으로 흑자 전환하며 연간 추정치(매출 1,301억원)의 46%를 이미 확보했고, 모듈 매출이 공시상 최초로 집계됐으며, 램리서치향 양산 부품이 하반기로 갈수록 확대되는 국면이다. 과거 밴드 상단이 장비사 진입에 대한 기대감이었다면, 현재는 장비사항 매출로 전환되기 시작한 구간이라는 점에서 멀티플 정당화가 가능하다고 판단한다.

아스플로 PBR 밴드 차트



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터



리스크 요인

그럼에도 반도체 업황에 달린 매출 구조

다운사이클에서는
여전히 취약한 구조

아스플로의 매출은 결국 전방 칩메이커와 장비사의 투자 및 가동 수준에 연동된다. 시공 부품은 신규 팹의 착공과 증설 일정에 따라 물량이 결정되고, 장비 부품 역시 장비사의 수주와 생산 계획에 후행해 발주가 이뤄지는 구조다. 따라서 반도체 업황이 둔화되어 칩메이커의 CAPEX 집행이 지연되거나 장비사의 출하가 감소할 경우, 승인 품목 확대와 무관하게 실적이 위축될 수 있다. 실제로 2023~2025년 다운사이클 구간에서 동사는 매출액이 869억원에서 679억원으로 22% 감소했고, 판가 하락이 겹치며 7개 분기 연속 영업적자를 기록한 바 있다.

여기에 고객사가 벤더를 추가 등록하거나 물량 배분 방식을 입찰로 전환할 경우 단가 협상력이 약화되는 점, 매출의 상당 부분이 국내 대형 고객사 2곳에 집중되어 있는 점도 업황 하강 국면에서 실적 변동성을 키우는 요인이다. 현 주가가 장비 부품 기업으로의 재분류를 반영한 수준인 만큼, 업황 둔화로 성장률과 마진 개선이 확인되지 않을 경우 밸류에이션 프리미엄이 되돌려질 가능성에 유의할 필요가 있다.

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
매출액	887	869	836	679	1,301
증가율(%)	50.5	-2.0	-3.8	-18.8	91.6
매출원가	696	706	728	635	1,026
매출원가율(%)	78.5	81.2	87.1	93.5	78.9
매출총이익	190	163	108	44	275
매출이익률(%)	21.4	18.7	12.9	6.5	21.1
판매관리비	85	99	127	114	122
판매비율(%)	9.6	11.4	15.2	16.8	9.4
EBITDA	136	96	15	-40	188
EBITDA 이익률(%)	15.3	11.1	1.8	-5.9	14.5
증가율(%)	120.1	-28.9	-84.4	적전	흑전
영업이익	105	64	-19	-70	153
영업이익률(%)	11.8	7.3	-2.2	-10.3	11.7
증가율(%)	164.9	-39.5	적전	적지	흑전
영업외손익	-5	-28	-8	-31	53
금융수익	0	2	1	5	57
금융비용	12	23	27	24	29
기타영업외손익	7	-7	18	-12	25
총속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	101	35	-27	-101	206
증가율(%)	157.9	-64.9	적전	적지	흑전
법인세비용	10	-1	-3	-2	26
계속사업이익	91	36	-24	-99	179
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	91	36	-24	-99	179
당기순이익률(%)	10.2	4.1	-2.8	-14.6	13.8
증가율(%)	127.6	-60.5	적전	적지	흑전
지배주주지분 순이익	91	36	-24	-99	179

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
영업활동으로인한현금흐름	-18	-31	55	-18	4
당기순이익	91	36	-24	-99	179
유형자산 상각비	30	32	33	26	32
무형자산 상각비	1	1	1	4	3
외환손익	10	3	0	0	0
운전자본의감소(증가)	-168	-111	28	33	-213
기타	18	8	17	18	3
투자활동으로인한현금흐름	-21	-28	-34	-25	-316
투자자산의 감소(증가)	-7	0	6	1	-3
유형자산의 감소	0	0	0	1	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-41	-34	-46	-42	-280
기타	27	6	6	15	-33
재무활동으로인한현금흐름	42	181	84	-75	226
차입금의 증가(감소)	60	180	106	-68	226
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	-18	1	-22	-7	0
기타현금흐름	-1	1	-1	1	-2
현금의증가(감소)	2	122	103	-117	-88
기초현금	64	66	188	291	174
기말현금	66	188	291	174	86

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025	2026F
유동자산	614	799	875	767	1,015
현금성자산	66	188	291	174	86
단기투자자산	12	6	5	36	69
매출채권	223	227	240	165	316
재고자산	275	334	294	311	390
기타유동자산	38	44	45	80	153
비유동자산	499	502	508	418	665
유형자산	422	421	437	346	594
무형자산	3	2	17	15	11
투자자산	9	8	16	4	7
기타비유동자산	65	71	38	53	53
자산총계	1,114	1,302	1,382	1,185	1,681
유동부채	504	617	638	674	876
단기차입금	239	382	500	460	590
매입채무	94	65	70	46	87
기타유동부채	171	170	68	168	199
비유동부채	70	110	197	47	162
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	40	67	158	22	117
기타비유동부채	30	43	39	25	45
부채총계	574	727	836	721	1,038
지배주주지분	539	575	547	464	643
자본금	67	67	67	67	67
자본잉여금	163	163	166	166	166
자본조정 등	-19	-14	-33	-27	-27
기타포괄이익누계액	2	1	8	8	8
이익잉여금	327	358	339	251	430
자본총계	539	575	547	464	643

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025	2026F
P/E(배)	14.1	38.8	N/A	N/A	16.1
P/B(배)	2.4	2.4	1.0	1.4	4.5
P/S(배)	1.4	1.6	0.7	0.9	2.2
EV/EBITDA(배)	11.8	18.5	63.4	N/A	19.0
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPS(원)	679	268	-178	-745	1,345
BPS(원)	4,044	4,310	4,099	3,479	4,824
SPS(원)	6,648	6,515	6,270	5,094	9,758
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	18.0	6.4	-4.2	-19.7	32.4
ROA	8.8	3.0	-1.8	-7.7	12.5
ROIC	12.2	7.0	-2.0	-7.8	12.3
안정성(%)					
유동비율	121.9	129.6	137.0	113.7	115.9
부채비율	106.5	126.5	152.9	155.4	161.3
순차입금비율	60.0	68.2	72.3	88.6	107.6
이자보상배율	8.6	2.7	-0.7	-2.9	5.7
활동성(%)					
총자산회전율	0.9	0.7	0.6	0.5	0.9
매출채권회전율	4.8	3.9	3.6	3.4	5.4
재고자산회전율	3.8	2.8	2.7	2.2	3.7

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공 정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다. ※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
아스플로	O	X	X

2026년 8월 24일 기준 소수계좌 거래집중 종목으로 지정된 바 있음.

발간 History

발간일	제목
2026.08.28	아스플로-시공 부품에서 장비 부품으로, 2026년이 진입 원년
2022.07.12	아스플로-반도체 제조 설비의 혈액 순환 촉진

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협회의 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양 질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생될 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/kirsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.